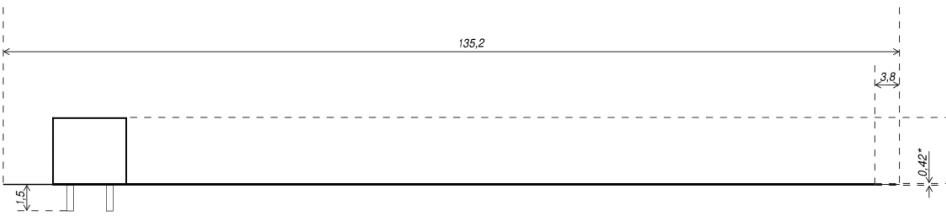


ທີ່ທຳ	ນະຄອນ	ບໍລິສັດ	ວຽກມ. ແນະກ.	ໂຄສະນ. ພ. ສະຕາມ	ໄທທີ່ ນະຄູມັດ.

Հործ

This diagram illustrates an exploded view of a circuit board assembly, likely a power supply or control module. The assembly includes several main components:

- Power Input:** A large rectangular component labeled **B** (47) is connected to a power source via terminal blocks **XS1** and **XS2**. A fuse **FU1** (46) is located between the input and the main board.
- Control and Logic:** A central integrated circuit **U1** (29) is connected to various resistors (**R1** through **R27**) and capacitors (**C1** through **C32**). It also connects to two optoisolators, **VD2** and **VD3**, which interface with switches **L1** and **L2**.
- Power Management:** A three-terminal regulator **U2** (25) provides power to the logic section. A boost converter **U3** (33) is connected to the main power rail and provides power to other components like **U4** and **U5**.
- Output Circuits:** The assembly features several output stages represented by large rectangles. These include a full-bridge inverter **DD1** (30), a half-bridge driver **DD2** (31), and a half-bridge driver **DD3** (32). Other outputs are labeled **Q1** (34), **Q2** (35), and **Q3** (36).
- Filtering and Protection:** Large electrolytic capacitors **C15** and **C16** (37) are used for filtering. Diodes **VT1** (38) and **VT2** (39) provide protection for sensitive components.
- Feedback and Sensors:** A feedback circuit **U4** (30) receives signals from sensors **S1** (49) and **S2** (50) to regulate the power supply.
- Other Components:** Various resistors (**R1** through **R30**), diodes (**VD1** through **VD3**), and connectors (**XS3** and **XS4**) are distributed throughout the assembly.



1. *Размеры для справок
 2. Габаритные размеры по наибольшим размерам выступающих деталей
 3. Монтаж выполнить согласно схеме электрической принципиальной
 4. Установку КМП выполнять согласно ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010
 5. Высота выступающих концов выбодов должно быть не более 0.5 мм
 6. Печатные проводники условно не показаны
 7. Пайку планарных соединений производить согласно ГОСТ 23592-96
 8. Пайку объемных соединений производить ПОС-61 ГОСТ 21930-76 согласно ГОСТ 23592-96
 9. Контроль паяльных соединений производить визуально оптическим методом
 10. Зоны А, В, С, D, Е защищть резиновым клеем ИКФ-130 ТУ 38.1051056-82 от попадания лака
 11. Плату покрыть лаком URETHAN 71 пневматическим распылением в один слой
 12. Маркировать заводской номер шрифт 2,5-Пр3 26.020-80 ПФ-115 белая ГОСТ 6465-76 ЧХ/12
 13. Остальные технические требования по ГОСТ Р 56427-2015